

10月24日(火) 15:15-17:30

セッションチエアマン： 不破 保博(元ローム株)・藤原 健典(東レ株)

◆ パネルレベルファンアウト FOLP®を用いた先端パッケージング技術



アオイ電子株式会社
製品企画開発部
課長代理
黒羽 淳史

[講演要旨]

近年では、前工程におけるプロセスの微細化の鈍化に伴い、半導体後工程の重要性が日増しに高まっています。弊社、アオイ電子では日本国内有数のOSATとして先端のパッケージング技術開発に日々取り組んでいます。今回は、パネルレベルパッケージング技術をベースに各市場に合わせたパッケージの開発取り組みについてご紹介します。

[講演者プロフィール]

2003年4月、香川大学工学部卒業し、アオイ電子株式会社に入社。技術部に所属し、新規PKGの開発に従事。ノンリードPKGや開口PKGを開発。2019年12月、製品企画開発部にて新製品の企画及び技術マーケティングを担当し、現在に至る。

◆ 3D実装時代の先端実装技術 ～これからのAI時代を支える最先端LSIの開発を目指して～



ヤマハロボティクスホールディングス株式会社
先端技術開発センター
センター長
谷口 恭弘

[講演要旨]

ChatGPTの登場以降、急速発展するAI技術を支える高速・高性能なLSIに対する要求が飛躍的に拡大しています。このような高性能LSIを製造するためには、接合技術やモールディング技術などのウエハの最先端三次元実装技術が必須となります。

本講演では、実装技術のトレンドを振り返り、先端フリップチップ実装技術や先端モールド技術について説明した後、ハイブリッドボンディングなどの次世代実装技術について紹介します。

[講演者プロフィール]

1995年3月大阪大学大学院工学研究科博士後期課程修了。株式会社東芝に入社。研究開発センターに所属し、ロボットビジョン、車載向け画像認識 LSI の開発に従事。

2017年8月本田技術研究所に入社、人混在ロボット向けの画像認識システムの開発に従事。

2022年9月ヤマハロボティクスホールディングス株式会社に入社。半導体製造装置の高性能化のための AI 技術活用および次世代製造技術の開発に従事。現在は、先端技術開発センター センター長として勤務。

◆ 半導体パッケージ向け材料の動向



味の素ファインテクノ株式会社
研究開発部 第3グループ
グループ長
宮本 亮

[講演要旨]

味の素ファインテクノは長きにわたり有機半導体向け基板向け層間絶縁材料を供給し続けており、半導体の高性能化に寄与してきました。昨今のデータ通信料増大に伴い、高周波対応と高密度対応の要求が高まっており、これらの要求に答える層間絶縁材料の動向をご紹介します。また、多様なパッケージ構造を可能にする封止樹脂についてもご紹介させていただきます。

[講演者プロフィール]

2009年 大阪大学大学院修士課程卒業

2009年 味の素(株)研究所に所属し、ABF ならびにその周辺材料の開発に従事

2016年 味の素ファインテクノ(株)に出向し、材料開発ならびに顧客サポートに従事

2019年 味の素ファインテクノ USA Corp.に出向し、半導体メーカーとの窓口を担当

2022年 味の素ファインテクノ(株)に出向し、現在に至る

※本講演に興味を持たれた方は、こちらの講演もご覧になっています。

【D-1】最新のパッケージ・実装技術動向

【D-2】シリコンフォトニクス・コパッケージ・ μ LED